

股票代码: 301282

股票简称: 金禄电子

公告编号: 2026-011

金禄电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议”，切实提高经营质量和投资回报水平，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案并经公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容如下：

一、行动方案基于的现状分析

（一）公司所处行业发展现状

公司所属行业为印制电路板（PCB）制造业。PCB被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元器件。2025年度，受以旧换新国补、购置税减免、智能化水平提升等多重因素影响，我国新能源汽车产销量继续保持高速增长；AI技术浪潮推动下，全球算力基础设施建设持续提速扩容，服务器、交换机及其他数据中心硬件设施供需两旺。在此带动下，PCB行业景气度提升，市场规模增长迈入快车道。根据Prismark2026年1月的报告，2025年度全球PCB产值预计为848.91亿美元，同比增长15.40%，其中增速最快的细分应用领域为服务器/数据存储和有线基础设施，同比增幅分别达到46.3%及36.3%。近年来PCB企业纷纷加码扩产布局，行业整体供给规模进一步扩大，在多数应用领域内卷及“价格战”短期内仍将持续。与此同时面向AI和算力的高端产能建设明显提速，PCB行业内部景气度呈现结构性分化，人工智能、算力基础设施、智能电动汽车、高速通信等新兴领域成为核心增长极，尤其是AI驱动下的算力基础设施的规模化建设与技术升级对PCB的需求持续激增，成为目前全球PCB市场最为重要的增量来源。

（二）公司生产经营现状

公司2025年度实现营业收入206,050.10万元，同比增长28.74%，主营业务收入中超过一半来自汽车PCB领域，算力基础设施、人工智能等新兴产业应用领域的收入占比较低。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润9,039.67万元，同比增长12.73%，受主要原材料金盐、铜球、铜箔、覆铜板等大幅涨价影响，公司盈利能力被明显侵蚀，主营业务毛利率同比减少2.61个百分点。公司目前产能利用率总体上维持在较高水平（2025年度约为84%），新增产能释放有序，市场营销端的压力主要来自加快新兴产业应用领域拓展力度、持续优化产品与客户结构以及与客户协商调价等方面；生产技术端的薄弱环节主要体现在20层以上刚性板、高阶HDI板等算力主流PCB产品的生产经验和积淀较为不足。

（三）公司治理及投资者关系现状

公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构。公司重视内控建设，持续开展内控制度设计与执行的自查自纠工作，积极改善内控薄弱环节，不断提高内部控制能力与规范运作水平。公司实施积极的利润分配政策，注重给投资者合理回报，上市后累计现金分红金额（含本年度预分红金额）达16,540.01万元，占公司上市后累计归属于上市公司股东的净利润（2022-2025年度）的比例为46.71%。公司致力于构建良好的投资者关系，通过不断提升信息披露质量、畅通投资者沟通渠道、积极倾听投资者意见和建议等方式强化投资者关系管理工作，但目前市值管理能力与投资者期望仍存在一定差距。

二、行动方案具体举措

（一）持续聚焦主业，提升经营质量

以AI和算力为引领的新一轮科技革命席卷而来，PCB行业景气度提升，发展前景向好。公司将持续聚焦主业发展，加快构建“1+6+N”的层次分明、协同联动的产品应用格局。汽车是公司产品最大的应用领域，占据半壁江山，公司将聚焦这一主战场，重点关注动力电池技术革新以及AI驱动下高阶智驾应用和推广带来的市场机会，巩固动力电池BMS应用领域的市场地位，提升智能驾驶应用领域的销售份额，推进整车企业、Tier1、智能座舱客户拓展的纵深维度；公司将着力深耕通信（新一代信息通信技术）、工控（机

机器人)、储能、防务、商业航天、算力基础设施等六条重点赛道，为业务持续增长寻求新的动力源；公司将不断扩大产品应用范围，积极在低空经济、新型显示、消费升级（智能穿戴、智能家电等）、智能安防、智慧医疗等新兴应用场景进行业务布局。与此同时，公司将通过持续推进提质降本增效工作、积极与客户协商调价等举措应对成本上涨压力，努力提升经营质量。此外，公司将加快推进广东清远生产基地PCB扩建项目的建设，在2026年下半年实现适配AI和算力产品的部分产线建成投产；通过添置内层、压合等工序设备，增加湖北安陆生产基地多层板产能；通过设备以旧换新和技术改造，提升四川遂宁生产基地制程能力；并将结合市场机会、以订单驱动为导向，充分研究论证扩充产能的其他可行举措。

（二）强化科技创新，发展新质生产力

公司将深入贯彻创新驱动发展战略，加快产品技术薄弱环节的攻坚克难，着力突破20层以上刚性板、高阶HDI、特殊工艺PCB的高良率量产过程中的技术难点与核心堵点；充分利用在技术同源的汽车PCB领域形成的研发积淀推进人形机器人传感器、驱动器、BMS等部件的PCB开发；重点卡位固态电池、汽车AI应用、卫星相控阵天线、航天电源等行业前沿应用的PCB产品适配和技术研发，推动公司产品围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向加速升级，加快培育新质生产力。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

公司将紧跟上市公司监管政策要求，持续推动完善法人治理结构，加强学习培训，强化控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，尤其是夯实其承诺履行、忠实勤勉履职、合规增减持公司股份的行为规范，努力提升公司治理水平和风险防范能力。

在内控能力建设方面，公司将常抓不懈，积极通过内部审计自查自纠、上市公司违规案例学习借鉴等机制识别内控缺陷并进行有效整改。与此同时，公司将以深入落实修订后的《上市公司治理准则》为契机，系统性梳理完善董事、高级管理人员的薪酬管理、绩效与履职评价等体系，并制定修订相关内控制度。

（四）提升回报水平，增强投资者获得感

公司牢固树立回报股东意识，将延续公司上市以来对股东较高比例利润分享的政策。2025年度在符合利润分配相关监管规定的前提下，公司充分考虑投资者的合理诉求，提

出了每10股派发现金红利1.50元（含税）并使用资本公积每10股转增4股的2025年度利润分配预案。根据公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的规定，在满足现金分红条件的前提下，2026-2027年度公司以现金方式分配的利润将不少于当年度实现的可分配利润的20%并积极向以前年度分红比例靠齐。公司积极响应中期现金分红的号召，在符合公司股东会批准的中期现金分红条件的前提下，后续每年至少将进行一次中期现金分红，通过增加现金分红频次，让投资者更为及时地分享公司的经营成果，增强投资者的获得感。此外，公司董事会将积极研究已回购的公司股份的用途，权衡员工激励与注销利弊后作出合理安排；并将视公司股价走势及市值管理需要，积极研究论证适时开展新一轮股份回购的可行性和必要性。

（五）提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司将认真履行信息披露义务，持续夯实信息披露质量，切实提升信息披露透明度和精准度，在依法披露必要信息的基础上，适时主动披露有助于投资者作出价值判断与投资决策的相关信息。公司充分倾听投资者意见和建议，在符合监管部门要求的前提下，已在《2025年年度报告》中较为详细地披露了公司在新兴产业应用领域的业务拓展情况并充分揭示相关风险；较大篇幅地增加了《2025年度社会责任报告》相关内容的披露，力求充分呈现公司在履行社会责任方面的实践和成效。公司将以合法合规为准绳，以投资者合理诉求为考量，努力提升信息披露工作服务投资者价值判断与投资决策的意识和能力。

公司将强化投资者关系管理工作，将2026年度确定为“投资者关系管理质量提升年”，在做好公司官网投资者关系专栏建设、畅通互动易/投资者热线/邮箱沟通渠道等工作的基础上，通过举办投资者开放日活动、增加定期报告业绩说明会召开频次等举措加强与投资者的沟通、倾听投资者的意见和建议。与此同时，公司将通过参加券商策略会、路演等方式加强与行业分析师、机构投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认识，促进公司投资价值合理反映公司质量，树立公司良好的资本市场形象。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日